

古河電気工業(株) 事業 IR 説明会 質疑応答録 (要旨)

日時：2021年6月11日(金) 14:15-15:00

内容：機能製品事業

説明者：執行役員常務 機能製品統括部門長 大野 良次

陪席者：AT・機能樹脂事業部門長 矢野 正三

サーマル・電子部品事業部門長 本村 拓也

メモリーディスク事業部門長 宮崎 秀彦

銅箔事業部門長 徳原 直文

機能製品統括部門企画統括部長 齊藤 孝史

取締役兼執行役員常務 財務・グローバルマネジメント本部長 福永 彰宏

Q：半導体製造用テープの多角化、多様化の進捗状況は？

A：スライドP8で事例を2件紹介したが、左は多角化の目玉商品として最も注力して開発を行っている。右はメモリ関係含めて既に納入を開始している。

Q：銅箔の改善状況は？

A：台湾の回路箔拠点は、火災前の生産能力に対し7割程度まで戻しており、現在フル操業。台湾、日本含めてお客様からの引合いは旺盛。需要も順調に伸びており、今期中に能力を8割まで戻す予定。

Q：半導体テープは韓国の競合メーカーによるシェア低下のリスクを抱えていると思う。中期および足元の状況は？

A：ロジック系半導体は、お客様が発熱量の課題を抱えており、相談しながら開発を進めている。先端技術に注力しており、新製品を上市し近いうちに必ず利益向上に繋げていく。

Q：サーマル製品は、フィリピン拠点の稼働も今年の夏に開始するとのことだが、どの程度の利益向上期待を持っているか？

A：現在フィリピン：中国＝6：4の生産比率を、今後8：2にしていく。今年度、全体では売上額を前年比+15%伸ばすなか、インフラ、データセンタ向けを中心とした主力工場にしていく。

Q：半導体製造用テープの投資に対する考え方は？

A：もともと設備投資より開発投資中心であるが、今後市場の伸びを取り込んでいく過程で増産投資を検討していく。現在は、新製品開発の最終段階であり、そこに注力している。

Q：高周波用銅箔について、古河の特長は？

A：表面の平滑性と樹脂との密着性がポイント。密着性確保のための表面処理方法について、お客様の使用する樹脂とのすり合わせを行いながら開発している。

Q：機能製品は多岐にわたる製品を持っているが、事業の絞り込みや不採算事業の縮小などの課題はあるのか？

A：事業ポートフォリオのあり方については、常に考える必要があると認識している。メモリーディスクやサーマル製品は、数年前はパソコン用途のウェイトが大きかったが、今はデータセンタ向け中心に変化。常に市場の変化を見据えながら、技術的な差別化ができなくなった領域は縮小し、伸びる市場に差別化製品を投入していく。

Q：この数年間で撤退した事業・製品はあるのか？

A：注力領域をパソコンから5Gやデータセンタに変えてきた。また、過去に需要の大きかったゲーム機向けは、現状では（差別化要素が限られているため）縮小していく製品群という位置づけ。

Q：半導体テープの競合参入について。シェア等の状況は？

A：日系メーカー4社での競合状態が形成されている。結果的に4社のシェアはほぼ安定しており、当社は足元では3位の位置づけにいる。

Q：メモリーディスクは、競争激化もあるなか売上・利益を拡大できるのか？

A：過去に主要な用途だったPC向けが減少し、現在はデータセンタ向けとして薄板化競争が厳しくなっている。薄板と耐衝撃性対応のための材料開発等により、お客様のニーズに応えていく。

Q：銅箔は、今後事業資産営業利益率をクリアする、という視点も鑑みた場合、予定している稼働状況を達成すれば以前のような高い収益性が見込めるのか？また、電池箔の位置づけをどう考えているか？

A：台湾の回路箔は、火災前の能力の8割まで復旧を計画。（もともとあった能力からの減少分である）2割分の低収益率製品の生産をやめ、ハイエンド製品に注力していくというシナリオ。フル稼働できれば、十分な利益が確保できると考えている。

我々の収益源は回路箔が主であり、特に高周波箔などのハイエンド製品に注力していく。電池箔はベースロードとしての位置づけであり、これ以上大きく伸ばすことは考えていない。

以上